**证券代码：688082 证券简称：盛美上海**

**盛美半导体设备（上海）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**编号：2024-01**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系****活动类别** | □特定对象调研 √分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 |
| **会议时间** | 2024年1月26日 |
| **会议地点** | 电话会议 |
| **上市公司****接待人员姓名** | 董事长：HUI WANG总经理：王坚财务负责人：LISA YI LU FENG董事会秘书：罗明珠 |
| **投资者关系活动****主要内容介绍** | 公司领导对公司2024年度向特定对象发行A股股票预案进行了简单介绍，并就投资者关心的问题进行了回答。* **问答环节**

**1、公司“研发和工艺测试平台项目”建设主要是针对Track的吗？**答：公司现阶段已有清洗设备、镀铜设备、炉管设备、PECVD、Track等产品，公司希望进行组合性、连贯性的测试。首先对硅片进行清洗，再通过炉管及PECVD完成镀膜，而后通过Track与光刻机的对接，完成涂胶、曝光、显影，然后进入实验线的刻蚀设备进行干法刻蚀，再进行去胶清洗。公司还配备SP7颗粒检测器及其他量测设备对各个工艺步骤进行检测验证。该项目目的就是可以在一条线上串联公司的五大产品，进行模拟生产线inline的测试，加快公司对各类设备的开发验证，缩短在客户端的测试验证时间。谢谢！**2、公司在光刻机的型号选择方面存在哪些考量？**答：公司在光刻机的购入方面并非优先选择先进的，KrF-line是公司首要的目标，但目前选定的最终型号还未定，国产的和国际的都可以。选KrF-line的原因主要是以下几点：1）KrF-line Track设备的市场最大，因为它的工艺步数最多，包含先进工艺和成熟工艺；2）国外某公司今年年底会推出400WPH的下一代KrF-line的光刻机，这要求Track需要做到450WPH的高产出率；3）300 WPH的KrF-line型号Track设备是公司进入市场的第一个产品，同时今年公司也将开发出浸润式的ArF Track设备。因此目前公司拟定的策略是先从KrF-line和300WPH切入，同时再逐步进行400WPH的开发。此外，公司的Track设备的目标不仅是解决国产化的问题，还希望进入全球市场。**3、请问领导是否能对公司高端半导体设备迭代研发项目展开描述？**答：首先是清洗设备，公司现阶段(截至去年底)已成功掌握95%的清洗工艺步骤的设备，公司的清洗设备包含单片正面、单片背面、边缘刻蚀、单片高温硫酸、Tahoe单片槽式组合清洗、兆声波清洗、先进IPA干燥技术及超临界CO2清洗等产品，工艺覆盖广泛。现阶段公司目标是将公司的产品做到更实更优，希望公司的设备不仅在中国市场占据主要份额，也在全球市场上被大量采用，为此公司将会继续加大对清洗设备的研发投入。此外，PECVD方面，公司拥有自己的差异化的设计，不同于业界现有的“一个腔体四个卡盘”以及“一个腔体两个卡盘”的设计，盛美采用独特的“一个腔体三个卡盘”的设计，可以兼顾两者的优势，在同一平台上实现多种PECVD工艺。公司具有自主研发独立知识产权的腔体内部设计，可以有效提高薄膜均匀性及薄膜应力控制，减少颗粒。今年公司预计将新增3-5家战略核心客户。谢谢！**4、现在公司海外的几个重要客户的具体进展是否能做一下分享？**答：1）目前美国一个大客户对产品反馈良好，后续较大机率可洽谈重复订单；2）欧洲客户的设备于去年9月进入，目前正在装机过程中，过程较为顺利，后续随着这第一台设备在这个欧洲大客户的验证完成后，未来也有重复订单；3）公司也在重点开发新加坡及周边的一些大客户，新加坡未来将会是半导体的热点区域，公司将紧跟这个市场；4）中国台湾市场方面，公司一直积极开拓，目前已有客户，特别是电镀设备方面已有多家客户在采用公司的设备，这一块未来也是公司的一大亮点；5）韩国区域，韩国海力士从2011年开始就是公司客户，现阶段公司也与其在多方面进行合作，且不仅是清洗设备，其他现有的几个产品公司都在积极和其推进合作。综上，在国际化上，公司在近年来已取得一定成就，今明两年将会是公司的一个发力点，能够将公司清洗、电镀设备率先推出进入市场，紧接着在中国把炉管设备、ALD、PECVD、Track验证完成后相继推出到国际市场。谢谢！**5、请问公司目前的产品在高端应用层面的进展和规划？**答：高端应用方面，公司已经量产清洗和电镀设备，并拿到批量的订单。电镀设备方面，目前盛美设备在生产线上能满足客户需求。此外，炉管设备、Track、PECVD等部分，炉管设备目前相对进程较快，因为ALD目前已经成功开发，目前已在客户端进行生产验证，并且客户数量在今年会有一个较大的拓展。**6、请问公司PECVD方面目前的发展方向是友商没有做的或者是比友商所做的更偏向高端制程的和更偏向存储的？对于友商现在已经做的较好的、拿到一定市场份额的公司怎么保证后续在这块能突击到一些较好的份额？对于客户而言，如这些产品目前友商在做但并没有做的很好，公司打算怎么拿到更好的市场份额？**答：公司在做PECVD的同时也在定位自己的产品，现阶段国内外PECVD的产品主要有两种设计。盛美的差异化设计的好处就是在同一个平台上仅需很小改动就可以实现国外两家大公司擅长的工艺，盛美工艺既能满足客户全面的工艺需求。因此主要的优点就是未来客户买一个平台就能实现基本上所有PECVD的工艺。此外，中端和高端工艺应用是公司的目标，既包括逻辑也包括存储，并且PECVD的难点主要是薄膜均匀性，薄膜应力和颗粒特性，公司核心设计上对这三个要点都非常注重，这也是未来核心竞争点，也是公司的产品优势。在这三个方面公司已有自己的全球IP布局。未来这个设备在中国研发并完成验证后将推向国际市场，这些差异化特点就是公司和国外大公司在市场上比拼的底气。**7、公司目前在先进封装设备的布局以及当前的进度？**答：公司较早就已在先进封装方面进行布局，2013年和2014年左右公司开始做清洗设备和涂胶显影设备。目前公司是全球先进封装湿法设备线种类最齐全的企业，如清洗、湿法刻蚀、涂胶、显影、去胶、电镀以及抛光设备（如电抛光）等都已用于多家客户端大生产线。**8、目前公司在先进封装布局的设备种类较全，请问目前公司在哪种设备上的进度更快？**答：公司在先进封装方面主要是和国际客户合作，未来5到10年先进封装在芯片产业上将越发重要，其深度、维度、技术难度都在提高，公司未来的策略会进一步加大在先进封装设备上的研发投入和市场开拓，未来公司国际市场开拓的一重要方向就是把镀铜设备导入韩国、台湾、美国、欧洲等全球市场。**9、请问2024年全球半导体设备市场中国和海外销售分别是什么情况？对公司而言新增订单将达到什么水平？领导对于25年后订单的增速会收敛的说法持什么态度？**答：中国的半导体芯片仍处于多年扩张期，因为中国的市场需求巨大。对市场而言，中高端产品只要做的出来一定有销路，同时随着企业扩大产品也将产生巨大的发展空间。因此中国企业只要在技术上不断的前进，未来市场是充足的，中国市场和国际市场一样，未来几年都还在成长期。**10、请问公司对2024年有什么订单方面的目标吗？**答：公司对2024年前景较为乐观，尤其中国市场将比去年更好。公司对中国市场未来几年发展充满信心。2024年，公司炉管系列产品加入销售行列，2025年，公司Track和PECVD也将加入销售行列支撑公司未来5到8年的高速成长。目前公司设置战略目标为实现国内销售占比50%，海外销售占比50%，总销售规模达到350亿人民币，从而进入全球半导体设备第一梯队行列。 |

**附：参与单位名称**

Ariose Capital

Cyber Atlas

JP Morgan

lygh capital

Panview Capital

Point 72

Torito Capital

安信基金

榜样投资

博时基金

东方阿尔法基金

东方基金

方正权益

方正自营

富敦投资

工银瑞信基金

广发基金

广发证券

国联安

国寿资产

国泰基金

海通证券

宏道投资

华泰电子

华泰证券

华夏基金

汇安基金

汇丰晋信

汇丰晋信基金

嘉实基金

建信基金

泾溪投资

景顺长城基金

径流资本

民生加银

南方基金

诺安基金

润晖投资

三星资管

上投摩根

拾贝投资

太平资产

新华基金

鑫然投资

兴证全球基金

银河自营

银华基金

涌容资产

圆信永丰基金

长城基金

长信基金

昭图投资

浙商证券

中金公司

中欧基金

中泰电子

中泰证券

中信建投

中信建投机械

中信建投证券

中信证券

中邮电子

中邮基金

中邮证券

朱雀基金